

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2026-019

# 深圳市民德电子科技有限公司 2025 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	民德电子	股票代码	300656
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈国兵	杨佳睿	
办公地址	深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层(1)号	深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层(1)号	
传真	0755-86022683	0755-86022683	
电话	0755-86329828	0755-86329828	
电子信箱	ir@mindeo.cn	ir@mindeo.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (一) 公司的主要业务和产品

报告期内，公司主要从事 AiDC 设备的研发、生产和销售业务，以及功率半导体晶圆代工、设计和分销业务。

##### 1、AiDC 业务

公司 AiDC (Artificial Intelligence for Data Capture, 应用人工智能进行数据采集) 业务，致力于人工智能在数据采集领域的应用推广，以 AI+CIS 的机器视觉技术平台，为汽车、3C、生物医疗检测设备先进制造业提供条码识读、OCR、器件颜色、尺寸、形状等各种数据采集解决方案的生产性服务，主要产品包括 AI 工业读码器、AI 感应影像平台、嵌入式 AI 扫描模组等机器视觉类产品。

##### 2、功率半导体业务

公司功率半导体业务以高端特色工艺半导体晶圆代工业务为核心，主要包含以下三项子业务：

(1) 功率半导体晶圆代工业务：公司功率半导体晶圆代工业务专注于特色功率半导体晶圆代工业务，聚焦高压、大功率半导体的研发与生产，在 6 英寸高端特色工艺晶圆代工产线的建设、运营及优化方面已取得了良好成果，已拥有深沟槽刻蚀工艺、平坦化砷阱工艺及缺陷控制技术、COOLMOS 工艺技术和结终端扩展技术等多项核心技术工艺，并拥有应用于 700V 高压 BCD 产品的智能功率集成电路的工艺平台。已量产代工产品包括 MOS 场效应二极管（MFER）、高压 VDMOS、高压 BCD、TVS 等功率器件，下游为功率半导体设计公司。

(2) 功率半导体设计业务：公司功率半导体设计业务主要产品包括 MOS 场效应二极管（MFER）、分离栅低压场效应晶体管（SGT-MOSFET）、超级结 MOSFET、快恢复二极管（FRD）等，主要应用在光伏逆变、储能、电源适配器、工业 PFC 等场景。

(3) 电子元器件分销业务：公司电子元器件代理分销业务以被动元器件（电容、电阻、电感、滤波器等）分销为主，下游主要覆盖汽车电子、移动通讯设备、云数据存储等领域的行业领先客户以及各类储能市场客户。

## （二）公司经营模式

公司主要业务经营模式如下：

### 1、AiDC 业务

公司从事 AiDC 技术和相关产品的自主研发工作，并采取自主设计、委外加工、自主总装及测试的模式进行 AiDC 设备及扫描引擎等核心模组产品的生产制造。公司的产品主要通过直销和经销相结合的方式，销往下游设备制造商、集成商和终端用户。

### 2、功率半导体业务

#### （1）功率半导体晶圆代工业务

控股子公司广芯微电子有限公司采用纯晶圆代工模式，主要从事 6 英寸高端功率半导体器件的晶圆代工业务，与功率半导体设计公司合作开发特色工艺技术平台，深度配合客户产品开发流程，帮助客户提升产品可靠性与性能、降低综合成本、缩短产品上市周期，与客户构筑形成长期合作伙伴关系。广芯微电子向上游采购硅片、特种气体等原材料，并采取定制化生产、包工包料的模式直接销售晶圆片给下游设计公司。

#### （2）功率半导体设计业务

控股子公司广微集成公司主要从事功率半导体器件的自主研发设计工作，并与代工厂合作开发特色工艺生产平台，采取代工生产的模式进行功率半导体器件的生产制造。产品通过直销和分销相结合的方式，销往下游芯片封测厂、分销商和终端客户。

#### （3）电子元器件分销业务

全资子公司泰博迅睿公司主要从事电子元器件分销业务，其主要经营模式：向上游电子元器件制造商原厂购入各类规格型号的电子元件，并通过自身的分销渠道，为下游客户提供电子元件及相应解决方案；同时，泰博迅睿公司也从事新能源动力和储能电池分销与供应链服务，为客户提供动力及储能电池产品与定制化解决方案。

## （三）报告期内公司所处行业情况

### 1、AiDC 业务

AiDC 业务中的条码识别技术作为最常见的自动识别技术之一，具有成本低、采集速度快、可靠性高等特点。近年来，随着物流、工业自动化等的快速发展，各行业的自动化水平、供应链复杂度不断提升，对数据准确性与实时性要求也越来越高；同时，人工智能（AI）正带动传统的物流、医疗、制造等行业升级转型，对智能化、高可靠性的条码识读设备需求将持续旺盛。

公司是中国率先实现独立自主研发条码识别设备的科技企业之一，也是为数不多的自主研发基于激光扫描技术和基于影像扫描技术微型扫描引擎的民族企业。为顺应 AI 时代浪潮，公司将条码识别业务战略升级为 AiDC（Artificial Intelligence for Data Capture，应用人工智能进行数据采集）事业部，致力于人工智能在数据采集领域的应用推广，基于 AI+CIS 平台技术，不断丰富机器视觉类产品，服务于中国高端制造业的升级。

### 2、功率半导体业务

公司晶圆代工业务，根据中华人民共和国统计局发布的《国民经济行业分类》（标准编号：GB/T4754-2017），公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”大类下“半导体分立器件制造（3972）”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司所处行业为战略性新兴产业分类中的“集成电路制造”（分类代码：1.2.4）。功率半导体设计业务，根据所处行业《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”，行业代码“6520”。

半导体产业作为信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的相关数据，2025年全球半导体销售额同比增长25.6%，达到7,917亿美元；展望2026年，市场有望进一步增长23%，达到9,750亿美元。而从国内来看，根据工业和信息化部公布的数据，2025年，我国的集成电路产量达4,843亿块，同比增长10.9%，集成电路产量维持了2024年以来的上涨趋势。

功率半导体作为半导体产业的重要分支，是电力电子装置电能转换与电路控制的核心，本质上，是通过利用半导体的单向导电性实现电源开关和电力转换的功能，来实现变频、变相、变压、逆变、整流、增幅、开关等，并兼具节能效用。功率半导体作为不可替代的基础性产品，被广泛应用于移动通信、消费电子、汽车电子、轨道交通、工业控制、发电与配电等电力电子领域，随着全球能源结构转型与“双碳”目标的深化落实，功率半导体市场需求快速增长。据 Research and Markets 数据显示，2025年全球功率半导体市场规模约为568.7亿美元，预计到2031年将增长至782.5亿美元，年复合增长率达5.46%。

当前，AI算力爆发式增长正在成为功率半导体增长的核心驱动力，并与全球能源结构迭代、新能源汽车高压化转型浪潮共振，围绕“高效电能转换、稳定高压供电”形成刚性需求，直接推动高压、大功率半导体成为行业增长的关键引擎；同时，行业前期库存优化已进入收尾阶段，供需格局迎来根本性扭转，为行业景气回升及量价齐升筑牢坚实基础，推动行业迎来高质量增长阶段。而台积电、三星等国际大厂的产能调整，向利润更高、需求更旺的先进制程倾斜，收缩成熟制程产能，这也为国内成熟制程晶圆厂带来一轮难得的客户导入机会与盈利弹性。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中明确提出，要提升产业链自主可控水平，加快新兴产业新赛道培育发展，集成电路产业，“要做精做细成熟制程”；国家和地方层面也持续出台相关产业支持政策，提升国产化产品使用率。功率半导体作为我国实现能源安全自主可控与节能降碳目标的核心基石部件，有望在政策护航与产业内生动力共振下驶入发展快车道。

科技创新和国产替代仍然是未来我国功率半导体产业的主要方向，国产功率半导体企业发展已取得了长足进步，但与国外品牌企业相比仍存在较大差距，国产功率半导体市场尚未形成稳定的竞争格局。伴随国内功率半导体厂商的不断进步，中国市场有望涌现一批世界级的功率半导体企业。

2018年6月，公司全资收购深圳市泰博迅睿技术有限公司，进驻半导体电子元器件分销行业。2020年6月，公司控股收购广微集成技术（深圳）有限公司，进入功率半导体设计行业。2025年1月，公司完成对浙江广芯微电子有限公司的控股收购，将产业链最核心环节功率半导体晶圆代工业务并入上市公司体系，广芯微电子主营业务为高端特色工艺半导体晶圆代工，聚焦高压、大功率半导体的研发与生产，致力于成为客户长期且值得信赖的功率器件和功率集成电路代工工厂典范。

公司是国内为数不多的在功率半导体产业链核心环节均有布局的上市公司，已完成了包括晶圆原材料（晶睿电子）、晶圆代工（广芯微电子）、先进功率器件特种工艺晶圆代工（芯微泰克）、芯片设计（广微集成、丽隼半导体、熙芯微电子）等核心环节布局。未来，公司将以晶圆代工厂广芯微电子为核心，持续打造功率半导体产业 smart IDM 生态圈，推动生态圈各环节项目的产能提升和扩产，以充分展现 smart IDM 生态圈的产业链协同效应，也为公司功率半导体产业长远发展构建深厚的护城河。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### （1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	2,267,549,770.30	1,590,427,817.13	42.57%	1,762,251,656.83
归属于上市公司股东的净资产	877,110,427.14	1,019,179,300.72	-13.94%	1,165,509,639.17
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	303,159,176.05	409,439,142.53	-25.96%	399,509,326.59
归属于上市公司股东的净利润	-101,787,784.06	-113,915,823.75	10.65%	12,555,711.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-184,187,950.83	-132,262,553.85	-39.26%	-17,481,933.47
经营活动产生的现金流量净额	3,552,507.80	111,311,531.45	-96.81%	97,655,330.22
基本每股收益（元/股）	-0.5981	-0.6644	9.98%	0.0727
稀释每股收益（元/股）	-0.5981	-0.6644	9.98%	0.0727
加权平均净资产收益率	-10.82%	-10.49%	减少 0.33 个百分点	1.08%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	53,978,990.49	76,095,075.51	94,129,154.74	78,955,955.31
归属于上市公司股东的净利润	33,471,035.44	-23,152,872.75	-21,519,945.17	-90,586,001.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,705,188.22	-23,762,230.89	-21,880,679.89	-120,839,851.83
经营活动产生的现金流量净额	-21,016,905.01	-9,914,227.75	21,522,372.46	12,961,268.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是  否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,635	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,529	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
许文焕	境内自然人	12.51%	21,408,351.00	16,056,263.00	质押	6,044,347.00			
许香灿	境内自然人	10.85%	18,561,437.00	0.00	不适用	0.00			
易仰卿	境内自然人	7.99%	13,679,971.00	12,312,728.00	质押	2,950,000.00			
黄效东	境内自然人	7.49%	12,822,107.00	9,616,580.00	质押	1,650,000.00			
新大陆数字技术股份有限公司	境内非国有法人	5.96%	10,194,517.00	0.00	不适用	0.00			
黄强	境内自然人	3.83%	6,548,085.00	0.00	不适用	0.00			

罗源熊	境内自然人	2.48%	4,250,318.00	0.00	质押	2,750,000.00
谢刚	境内自然人	2.24%	3,839,508.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	1.16%	1,983,444.00	0.00	不适用	0.00
高枫	境内自然人	1.14%	1,956,824.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		许香灿先生和许文焕先生系父子关系，合计持有公司 23.36% 的股权，为公司的控股股东和实际控制人。				

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用  不适用

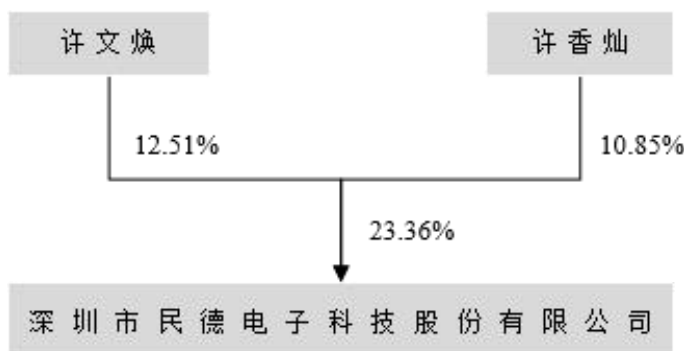
公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

三、重要事项

(一) 经营情况

本报告期内，公司主营业务收入主要来源于 AiDC 业务和功率半导体业务。报告期内，公司实现总营业收入 30,315.92 万元，较上年同期减少 10,628.00 万元，同比减少 25.96%，主要原因系：（1）公司于 2025 年 11 月初将持有的控股子公司君安技术公司 51% 的股权全部转让，君安技术公司不再纳入公司合并报表范围，君安技术公司业务存在明显的季节性，四季度验收确认收入的金额较大，其 2025 年 11-12 月收入不再计入公司合并营业收入，对公司总营收产生一定影响；（2）因 2025 年广芯微电子公司纳入公司合并财务报表范围，其与全资子公司民德（丽水）之间的设备租赁收入不再计入 2025 年合并营业收入。

本报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-10,178.78 万元，较上年同期增加 1,212.80 万元，同比增加 10.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,418.80 万元，较上年同期减少 5,192.54 万元，同比

减少 39.26%。主要原因系：（1）公司于 2025 年 1 月完成对广芯微电子的控股收购，根据会计准则核算，公司合并广芯微电子产生了部分投资收益，对公司非经常性损益有一定影响；（2）报告期内，公司对收购广芯微电子产生的商誉计提了 4,526.06 万元的减值准备；（3）报告期内，广芯微电子产能稳步提升，收入较上年同期大幅增长，但项目仍处于产能爬坡阶段，整体收入规模较小，而设备折旧摊销及人员等固定成本随着产能的提升较上年同期增加，导致广芯微电子仍处于亏损状态，且净利润同比减少；此外，广芯微电子自 2025 年 1 月纳入公司合并报表范围，公司持股比例的增加也对归属于上市公司股东的净利润产生了一定影响。

本报告期内，公司经营活动产生的现金流净额 355.25 万元，较上年同期减少 10,775.90 万元，同比减少 96.81%，主要原因系：2025 年 1 月，广芯微电子有限公司纳入公司合并财务报表范围，因广芯微电子尚处于产能爬坡阶段，其生产经营活动产生的支出金额大于收入金额。

## （二）重要投资事项

为进一步提升公司核心竞争力，增强对核心战略资产的掌控力度，公司于 2024 年启动了控股收购广芯微电子公司的交易，并于 2025 年 1 月 2 日完成交易的工商变更，公司目前持有广芯微电子有限公司 50.1% 股权，广芯微电子有限公司已成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围，具体详见公司于巨潮资讯网上公布的《关于收购浙江广芯微电子有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：2025-001）。

公司于 2025 年 11 月 5 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。为优化资源配置、聚焦核心业务发展，公司将持有控股子公司君安宏图技术公司 51% 的股权，以人民币 1,480 万元的价格转让给杭州君海启辰企业管理合伙企业（有限合伙）。上述交易于 2025 年 11 月 13 日完成交割，公司不再持有君安宏图技术公司的股权，君安宏图技术公司不再纳入公司合并报表范围。具体详见公司于巨潮资讯网上公布的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-071）、《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2025-078）。

深圳市民德电子科技股份有限公司

法定代表人：黄效东

2026 年 4 月 28 日